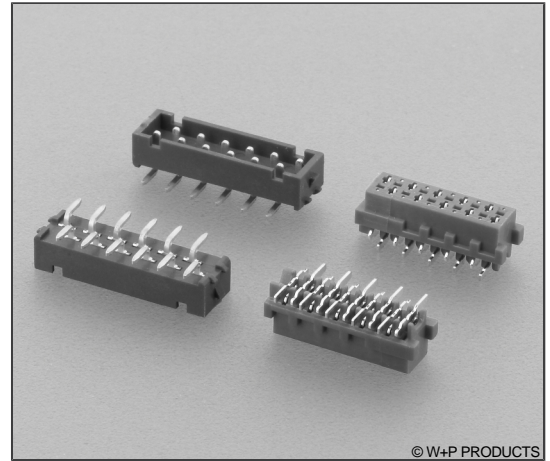


Technische Daten / Technical Data

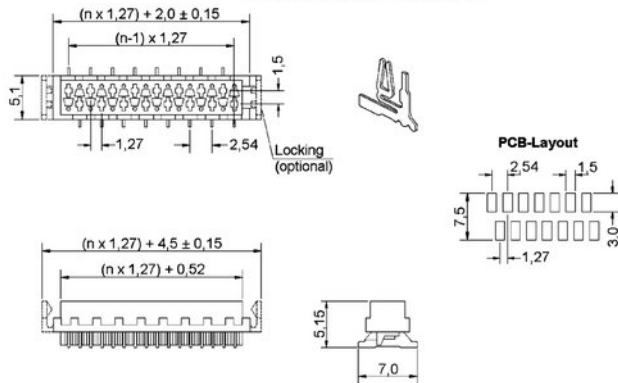
| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Farbe <i>Colour</i> | Rot <i>Red</i> |
| Kontakmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20mΩ < 20mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000MΩ > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500V _{RMS} 500V _{RMS} |
| Nennspannung <i>Voltage Rating</i> | 100V _{RMS} 100V _{RMS} |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 1,5A 1.5A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40°C ... +105°C -40°C ... +105°C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i> |



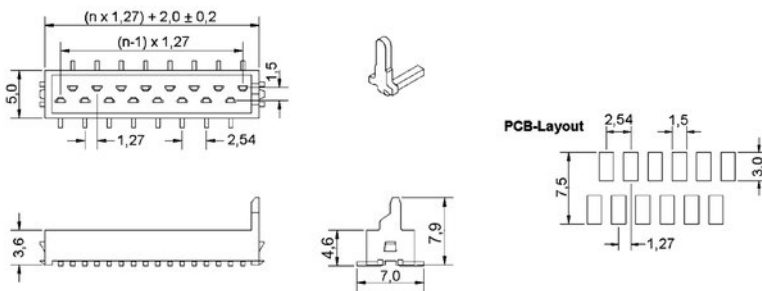
© W+P PRODUCTS

Kompatibel zu Serie 699
Compatible to Series 699

Female-on-Board Connector / SMT



Male-on-Board Connector / SMT



Series

6990

Type*

5

5 Buchse
Female-on-board
6 Stiftleiste
Male-on-board

Contacts*

02

04 06 08 10 12
14 16 18 20

Locks (Optional)*

1

[] Ohne Rast-Clips
W/o locks
1 Mit Rast-Clips
With locks

Packaging*

ST

ST
PPST
TR (Option)
FTR (Option)
PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes
PPST In Stangen mit Pick&Place-Pads / In tubes with Pick&Place-Pads
TR (Option) Tape & Reel ohne Pads / Tape & Reel w/o Pads
FTR (Option) Tape & Reel mit Folien-Pads / Tape & Reel, with film tape
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

